



新製品



“世界最速レベルの高速動作によるハイクオリティパフォーマンス“

小口径ウエハ対応高速アライナ



OFH - 4003 を新発売！

- 新生ACTRANSでスループットの向上に貢献！ -

株式会社ダイヘン（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長 田尻哲也）は、世界最速レベルのアライナ（位置合わせ装置）のシリーズとして、小口径ウエハ対応の高速アライナを12月より発売します。

昨今、各種液晶パネルのバックライト光源をはじめ、照明などへLED（発光ダイオード）の採用が広がっています。又、太陽光発電の普及に牽引され、インバータなどに使われるパワーデバイス市場も順調に拡大を続けています。これらのデバイス製造は、小口径ウエハでの生産が主流であり、今後小口径ウエハに対応した製造装置の需要拡大が期待されます。

このような背景の中、当社では昨年取得したMECS（ ）のクリーン搬送事業に当社独自の技術を融合し、従来からご好評頂いている世界最速（位置合わせ速度）アライナに加え、新たに小口径ウエハに対応した高速アライナを開発致しました。当社の大気搬送ロボットと組み合わせることにより、最適ソリューションで、お客様の「装置生産性（スループット）向上」に貢献いたします。

200ミリ以下のサイズのウエハ搬送クリーンロボット分野において、1999年以前に国内トップシェアを獲得していたブランド。

今回発売する新製品名

**新型 高速ウエハアライナ OFH - 4003**

主な用途

LED、パワーデバイス等、小径ウエハ対応半導体製造装置

## 新製品の主な特長・スペック

1. 2～6インチウエハに対応しており、装置側からの指令で各サイズのウエハへ対応できます。ウエハサイズを大口径化し、生産ラインを変更される場合でも、即時に対応が可能です。
2. 従来モデル OFH-4000 シリーズの最新製品として、高速高精度な位置決めを継承しています。
3. サファイヤウエハ、石英ウエハ等への対応モデルも充実しています。(Qモデル)
4. 当社クリーン搬送ロボットと組み合わせることにより、最適な搬送システムの構築が可能です。
5. RoHS 指令へも対応しています。



仕様 Specification

	OFH-4000	OFH-4001	OFH-4002	OFH-4003
対象ウエハ Wafer Size (*1)	200～300mm	150～200mm	100～200mm	50～150mm
アライメント時間 Alignment Time	1.8sec. (*2)			
位置決め精度 Accuracy	XY: ±0.1mm    θ: ±0.2°			
クリーン度 Cleanliness	ISO Class 3 (ISO-14644)			
本体質量 Mass	8kg			

\*1. 石英ウエハ対応にはQモデルがあります。  
\*2. 50mm (2インチウエハ) は、2.5sec. です。

## メーカー希望価格

ACTRANS OFH-4003 : 1,600,000円

## 発売日

2011年12月

## 問い合わせ先

株式会社ダイヘン 半導体機器カンパニー 企画部 菅根 正之

TEL : 06 - 6390 - 5575

FAX : 06 - 6308 - 6372

URL : <http://www.daihen.co.jp/handoutai/>